第 113 回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 28年 5月 20日(金) 10:30～16:30

場 所：大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913 会議室(東京 日本橋)

	時 間	題 目	講 演 者
平成 28 年 5 月 20 日 (金)	司 会 岩田剛治 (大阪大学)		
	10:30～11:15	『半導体モジュール技術と分子接合技術』 (資料番号MJ-691-2016)	(株)東芝ストレージ&デバイス ソリューション社 ○八甫谷明彦
	11:15～12:00	Mate2016 受賞講演 『パワーモジュール向けピラー状 IMC 分散 鉛フリーはんだ接合部の開発』 (資料番号MJ-692-2016)	カルソニックカンセイ(株) ○中田裕輔、橋本富仁 群馬大学 荘司郁夫、林 和
	12:00～13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～13:10	委 員 会 議 事	
	司 会 柴崎正訓 ((株)タムラ製作所)		
	13:10～13:55	Mate2016 受賞講演 『ミニマルファブによる前工程と パッケージング工程のハーフインチ統合生産システム』 (資料番号MJ-693-2016)	¹ 産業技術総合研究所 ² ミニマルファブ技術研究組合 ○居村史人 ¹ 、井上道弘 ¹ 猿渡新水 ^{1,2} 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 原 史朗 ^{1,2}
	13:55～14:40	Mate2016 受賞講演 『埋込型パワーデバイスパッケージの 配線設計の熱特性に関する研究』 (資料番号MJ-694-2016)	(株)ジェイデバイス ○松原寛明、近井智哉、林 直毅 今泉有加里、岩崎俊寛、谷口文彦
	14:40～14:50	休 憩	
	司 会 西川宏 (大阪大学)		
	14:50～15:35	『樹脂補強効果を有する低温はんだ接合材料の開発』 (資料番号MJ-695-2016)	(株)タムラ製作所 ○三木禎大、岡田直記 西川大英、島田利昭
	15:35～16:20	『微粒子分散樹脂ロッドを用いた ガスフレーム溶射法による皮膜形成』 (資料番号MJ-696-2016)	日本コーティング工業(株) ○鷹井一登
	16:20～16:30	MJ 賞 表彰式	

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。